



# サーマルマネジメント研究会 2024年度第2回公開研究会

主催:サーマルマネジメント研究会

## ◆公開研究会のご案内

サーマルマネジメント研究会2024年度第2回公開研究会をハイブリッド開催致します。今回はサーマルマネジメントに関する講演4件で構成いたします。

開催日時 2025年3月24日 13:20~17:00

開催方式 現地開催 & WEBハイブリッド(Zoom Webinarシステム利用)

開催場所:回路会館・地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

## <本公開研究会の概要>

サーマルマネジメントに関するさまざまなトピックについて紹介する。高熱伝導化のための浸透現象の発現や、他の熱物性(熱輻射、熱膨張)の向上の工夫などについて、大阪工研協会の上利氏に、サーモリフレクタンス顕微鏡による熱物性計測について、サイエンスエッジの内山氏に、自励振動ヒートパイプ冷却技術の開発について、日立製作所の鍋島氏に、電子機器放熱部材としてのヒートパイプの熱輸送能力および各種熱伝導部材の熱伝導率測定手法について、アドバンスドナレッジ研究所の大串氏に、それぞれご講演頂く。

13:20~13:30

### オープニング

司会 サーマルマネジメント研究会 主査 西 剛侗(足利大学)

13:30~14:20

「サーマルマネジメント材料の概説と、壁を乗り越えた種々の技術」  
(一社)大阪工研協会 常務理事 上利 泰幸 氏

14:20~15:00

「ナノ構造の熱物性を計測するサーモリフレクタンス顕微鏡と半導体分野への応用」  
サイエンスエッジ(株) 代表取締役社長 CEO 内山 知也 氏

(休憩20分)

15:20~16:00

「自励振動ヒートパイプ冷却技術の開発」  
(株)日立製作所 研究開発グループ 研究員 鍋島 史花 氏

16:00~16:40

「電子機器放熱部材の熱輸送特性・熱伝導率測定手法」  
(株)アドバンスドナレッジ研究所 伝熱冷却研究室 技術顧問 大串 哲朗 氏

16:40~17:00

総合討論及びクロージング  
司会及び講演者

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

次のような方におすすめです。

- ・電子機器の熱設計にこれから関わる方/既に関わっている方
- ・サーマルマネジメント材料の概論を学びたい方
- ・パーコレーション現象による熱伝導率向上について興味をお持ちの方
- ・熱物性測定に興味をお持ちの方
- ・ヒートパイプ技術に興味をお持ちの方

#### 協賛団体

一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)、日本熱物性学会、公益社団法人化学工学会 エレクトロニクス部会、公益社団法人 日本伝熱学会

## 参加要項

定員 回路会館・地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)  
WEB (Zoom Webinar): 100名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

#### 参加費(消費税込み)

正会員・賛助会員:5,000円、協賛団体会員:5,000円、学生会員:1,000円、  
研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円、名誉会員:無料、非会員一般:10,000円、  
非会員学生:2,000円

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

## 注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。  
(お支払い方法:クレジットカード決済・コンビニ決済)(手数料学会負担)
- ③**領収書(宛名会社名選択可)**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。
- ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。

\*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会  
E-mail: info@jiep.or.jp  
(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)